



2018年11月 吉日
芝浦メカトロニクス株式会社
芝浦エレテック株式会社

「SEMICON Japan 2018」出展のご案内

拝 啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12月12日(水)～14日(金)、東京ビッグサイトで開催される『SEMICON Japan 2018』に出展いたします。

芝浦メカトロニクス(株)は、長年培ってきたコア技術(精密メカトロニクス、洗浄、成膜、エッチング、真空、貼り合せなど)を結集して、半導体、電子部品、フラットパネルディスプレイ、光学薄膜などの用途向けに製造装置の開発からサービスまでトータルソリューションを提供しています。

また、芝浦エレテック(株)は「ソリューションを提供する総合サービス会社」として様々な協力会社様と連携し、ワンストップサービスを提供しています。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ちしております。

敬 具

－ 記 －

日 時 : 2018年12月12日(水)～14日(金) 10:00～17:00
会 場 : 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟
展示ブース : 東展示棟 Hall4 小間番号 4034
Web サイト : <http://www.semiconjapan.org/jp/>

主な出展品目：

■ 芝浦メカトロニクス株式会社

1) パネル展示

枚葉式リン酸エッチング装置 (SC300-HT8)
メモリ向け枚葉式洗浄・エッチング装置 (SC310)
ウェーハ向け枚葉式洗浄・エッチング装置 (SC200/300)
ドライエッチング装置 (CDE/RPA)
フォトマスクエッチング装置 (ARES)
FO-PLP 用ボンディング装置 (TFC-9300)
2.5D PKG 用ボンディング装置 (TFC-6000GW)
EMI シールド用スパッタリング装置 (CCS リリーズ)
パワー半導体用スパッタリング装置 (SWN-5000)

■ 芝浦エレテック株式会社

1) 実機展示

ウェーハ目視外観検査用ステージ

2) モニタ展示

IoT ツール (XiNO®、マルチインフォメーションシステム)
リノベーション事例

3) パネル展示

中古装置事業 (世界中のネットワークを駆使した中古装置サービス)
ウェーハレーザーマーカ など

芝浦エレテック株式会社 出展品目のご紹介

実機展示

- ・ 300mm ウェーハを自在に回転・傾斜が可能
回転角 360°∞ / 傾斜角±20°
- ・ 手動でも自動でも制御可能



ウェーハ目視外観検査用ステージ

モニタ展示

生産設備に IoT の導入を検討してみませんか？



マルチインフォメーションシステム



XiNO®

モニタ展示



リノベーション事例

パネル展示



ウェーハマーカ LAY-775 シリーズ

- ・ クリーンで高速なマーキング
- ・ コンパクト設計
- ・ 簡単メンテナンス（完全空冷 LD 励起）
- ・ 200mm -300mm 対応（Open/Foup 対応）
- ・ ウェーハ厚 400 - 3500μm 対応

【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社 CSセンター CS企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

WEB サイト : <http://www.shibaura.co.jp/eletec/>

